REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-253006 CG-DL-E-14032024-253006

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184] No. 184] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2024/फाल्गुन 24, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2024/PHALGUNA 24, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2024

सं. 03/2024- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 197(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य और हॉग कॉग (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी)", (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक 8534 00 00 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना फाइल संख्या 6/16/2022-डीजीटीआर, दिनांक 29 दिसंबर, 2023, जिसे दिनांक 29 दिसंबर, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि –

- (i) विषयगत माल का विषयगत देशों से भारत को निर्यात इसके सामान्य से कम मूल्य पर किया गया है;
- (ii) घरेलू उद्योग को विषयगत देश से संबद्ध आयात के कारण सारवान क्षति हुई है;
- (iii) विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं के भारी आयात के कारण सारवान क्षति हुई है;

घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है; अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धाराओं (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन उप शीर्ष अथवा टैरिफ मद के अंतर्गत आती है: जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है, उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में सीआईएफ मूल्य का % के रूप में प्रतिपाटन शुल्क लगाती है; यथाः-

क्र.सं.	उप शीर्ष	वस्तुओं का	मूलत :का देश	निर्यातक	उत्पादक	सीआईएफ
	अथवा	विवरण		का देश		के % के
	टैरिफ मद					रूप में
						शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	85340000	प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी)*	चीन जन गण.	चीन जन .गण. सहित कोई	जि आन शेंगयि इलैक्ट्रानिक्स कं. लि. शेंगयि इलैक्ट्रानिक्स कं.	शून्य
		(पाताजा)		भी देश	लि.	
2	-वही-	-वही-	चीन जन गण.	चीन जन .गण. सहित कोई भी देश	डब्ल्यूयूएस प्रिंटेड सर्किट केईपीजेड (कुनशान) कं. लि. डब्ल्यूयूएस प्रिंटेड सर्किट (कुनशान) कं. लि. डब्ल्यूयूएस प्रिंटेड सर्किट (कुनशान) कं. लि.	शून्य
3	-वही-	-वही-	चीन जन गण.	चीन जन .गण. सहित कोई भी देश	जियांग्सी जुशेंग इलैक्ट्रानिक्स कं. लि.	शून्य
4	-वही-	-वही-	चीन जन गण.	चीन जन .गण. सहित कोई भी देश	जियांगमेन सनटाक सर्किट टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड शेनझेन सनटाक मल्टीलेयर पीसीबी कं. लि. डालियान सनटाक इलैक्ट्रानिक्स कंपनी लिमिटेड डालियान सनटाक सर्किट कंपनी लिमिटेड झुहई सनटाक सर्किट टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	शून्य
5	-वही-	-वही-	चीन जन गण.	चीन जन.गण.	शेनझेन किनवोंग इलैक्ट्रानिक्स कंपनी	14.78%

सारणी

0
- 1
J

				सहित कोई	लिमिटेड	
				भी देश	जियांग्सी किनवोंग प्रिसिजन सर्किट कंपनी लिमिटेड	
					किनवोंग इलैक्ट्रानिक टेक्नोलॉजी (लोंगचुआन) कंपनी लिमिटेड	
					किंगवोंग इलैक्ट्रानिक टेक्नोलॉजी (झुहाई) कंपनी लिमिटेड	
6	-वही-	-वही-	चीन जन गण.	चीन जन .गण. सहित कोई भी देश	किन यिप टेक्नोलॉजी इलैक्ट्रानिक्स (हुईझाऊ) कंपनी लिमिटेड	75.72%
7	-वही-	-वही-	चीन जन गण.	चीन जन .गण. सहित कोई भी देश	शेन्नान सर्किट्स कंपनी लिमिटेड नानटोंग शेन्नाम सर्किट्स कंपनी लिमिटेड बुक्सीशेनान सर्किट कंपनी लिमिटेड	शून्य
8	-वही-	-वही-	चीन जन गण.	चीन जन .गण. सहित कोई भी देश	कालेक्स मल्टी-लेयर सर्किट बोर्ड (झोंगशान) लि. मेरिक्स प्रिंटेड सर्किट्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड गुआंगझोऊ ट्रमब्रे इलैक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी कं. लि. डोंगगुआन मीडविले सर्किट्स कंपनी लिमिटेड	शून्य
9	-वही-	-वही-	चीन जन गण.	चीन जन .गण. सहित कोई भी देश	जियांग्सी लोंघई सर्किट टेक्नोलॉजी कं. लि.	8.23%
10	-वही-	-वही-	चीन जन गण.	चीन जन .गण. सहित कोई भी देश	शेनझेन सिनवेईसई इलैक्ट्रानिक्स कंपनी लिमिटेड	14.06%
11	-वही-	-वही-	चीन जन गण.	चीन जन .गण. सहित कोई भी देश	कई पिंग इलैक्टएंड . एलटेक कंपनी लिमिटेड कई पिंग इलैक्ट. एंड एलटेक नं. 3 कंपनी लिमिटेड	शून्य
12	-वही-	-वही-	चीन जन गण.	चीन जन .गण. सहित कोई भी देश	शनशाइन ग्लोबल सर्किट्स कंपनी लिमिटेड जियु जियांग शनशाइन सर्किट्स टेक्नोलॉजी कं. लि.	शून्य

13	-वही-	-वही-	चीन जन गण.	चीन	इनो सर्किट्स लिमिटेड	10.14%
	161	101		जन .गण.		10.1470
				सहित कोई		
				भी देश		
14	-वही-	-वही-	चीन जन गण.	चीन	क्रम संख्या को 13 से 1	30%
				जन .गण.	छोड़कर कोई भी	
				सहित कोई		
				भी देश		
15	-वही-	-वही-	चीन	चीन	कोई भी	30%
			जनऔर .गण.	जन गण.		
			हॉग कॉगको			
			छोड़कर कोई			
			भी देश			
16	-वही-	-वही-	हॉग कॉग	हॉग कॉग	कोई भी	30%
				सहित कोई		
				भी देश		
17	-वही-	-वही-	चीन	हॉग कॉग	कोई भी	30%
			जनऔर .गण.			
			हॉग कॉगको			
			छोड़कर कोई			
			भी देश			

* निम्नलिखित पीसीबी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाता है: -

- i. 6 लेयर से अधिक के पीसीबी
- ii. मोबाईल फोन उपयोगों में उपयोग के लिए पीसीबी
- iii. सभी आकारों के पोपुलेटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड
- iv. एमबेडेड कॉपर कॉइन वाला पीसीबी

पीसीबी एमबेडेड कॉपर काइन वाले पीसीबी वे पीसीबी हैं जहां एक मेटल ब्लॉक को इन बोडौँ के बीच में इमबेड किया जाता है। एमबेडेड कॉपर काइन वाले पीसीबी का मुख्य रूप से उपयोग बेस स्टेशन एम्पलीफायर उत्पादों जैसे बहुत अधिक ताप डिसिपेसन की आवश्यकता वाले उच्च शक्ति प्राप्त उपकरणों के लिए किया जाता है।

v. इनले पीसीबी

इनले पीसीबी वे पीसीबी हैं, जहां कॉपर एल्युमिनियम अथवा अन्य सामग्री इसमें डाली जाती है अथवा उसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में दबाया जाता है और यह नीचे की ओर हीट सिंक तक प्रिंटेट सर्किट बोर्ड के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक संघटक के ताप को कम करता है। ताप को बाहर निकालने वाला संघटक सीधे तौर पर मेटल इनले से जोड़ा जा सकता है। को (ताप स्रोत) इनले पीसीबी का मुख्य रूप से उपयोग उच्च बारम्बारता और उच्च गति के उत्पादों के लिए किया जाता है।

vi. प्लेटेड ओवर फील्ड वाया (पीओएफवी) पीसीबी अथवा वाया-इन-पैड पीसीबी

पीओएफवी उत्पाद सोल्डर किए जाने के लिए एसएमडी (सर्फेस माउंटेड कम्पोनेंट) पैड में कंडक्टिव होल्स रखकर स्थान की बचत करने के लिए बनाया जाता है। होल्स में जाने वाले तदनंतर सोल्डरिंग पेस्ट और फाल्स सोल्डरिंग रिंग बनने से बचने के उद्देश्य से, इन होल्स को अग्रिम रूप में रेसिन के साथ भरे जाने की आवश्यकता होती है। बाद में, इस सतह को स्पाट किया जाता है ताकि होल्स के साथ पैड्स का सतह चिकना हो और सोल्डरिंग को प्रभावित नहीं करता हो। पीओएफवी पीसीबी में, सतह को कॉपर के साथ प्लेट किया जाता है। पीओएफबी पीसीबी का मुख्य रूप से उपयोग वायरलेस बेस्ड स्टेशन उत्पादों, स्विच, और राउटर जैसे उच्च विश्वसनीयता आवश्यकताओं के साथ उत्पादों में किया जाता है।. vii. उच्च घनत्व इंटरकनेक्ट (एचडीआई) पीसीबी

एचडीआई पीसीबी वे हैं जिनमें छिद्रों की ड्रिलिंग ≤ 0.1 एमएम के छिद्र के आकार के साथ लेज़र प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जाता है। इस तरह के छोटे छोटे छिद्रों की ड्रिलिंग के लिए लेजर ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है। यह उच्च प्रोसेसिंग गंभीरता बाली एक प्रौद्योगिकी है। एचडीआई पीसीबी का मुख्य रूप से उपयोग उच्च घनत्व वाले उत्पादों जैसे मोबाईल फोन, स्विच और सर्वर के लिए किया जाता है।.

viii. रेजिड-फ्लेक्स पीसीबी

रेजिड-फ्लेक्स पीसीबी फ्लेक्सिबल और रेजिड सर्किट बोर्ड का मिश्रण है। रेजिड फ्लेक्स पीसीबी फ्लेक्सी बोर्ड रेजिड बोर्ड दोनों की अच्छे गुणों को समाहित करता है। रेजिड फ्लेक्स उत्पादों का मुख्य रूप से उपयोग मोबाईल फोन, ऑटोमोबाइल, औद्योगिक नियंत्रण और अन्य उपयोगों में किया जाता है जहां इलैक्ट्रानिक पार्ट्स संस्थापित करने के लिए सीमित जगह होती है।

xi पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स/आईसी पैकेजिंग

पैकेजिंग सब्स्ट्रेट्स अथवा इंटरग्रेटेड सर्किट्स (आईसी) सबस्ट्रेट खुले इंटरग्रेटेड सर्किट्स (सेमी कंडक्टर) चिप्स की पैकेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाला एक बेस बोर्ड है। वे पीसीबी को सेमिकंडक्टर चिप से जोड़ने में महतवपूर्ण भूमिका निभाता है। आईसी सबस्ट्रेट सेमिकंडक्टर चिप पर कब्जा करता है, पीसीबी के साथ इस चिप को जोड़ने के लिए राउट करता है तथा आईसी चिप को सुरक्षा प्रदान करता है, उसका सहायता प्रदान करता है और उसे मजबूत बनाता है और उसके कारण इसे तापीय डिसिपेशन टनल देता है।

2. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) तक की अवधि के लिए लगाया जाएगा और यह भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण –इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपाटन शुल्क, की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई है और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/29/2024 टीआरयू- अनुभाग सीबीईसी]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2024

No. 03/2024-Customs (ADD)

G.S.R. 197(E).—Whereas in the matter of 'Printed Circuit Boards (PCB)' (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff heading 8534 0000 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR and Hong Kong (hereinafter referred to as the subject countries), and imported into India, the designated authority in its final findings, *vide* notification No. 6/16/2022-DGTR dated the 29th December, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 29th December, 2023, has *interalia*, come to the conclusion that—

- (i) the subject goods have been exported to India from the subject countries below normal values;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury on account of subject imports from subject countries;

(iii) the material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject countries,

and has recommended imposition of an anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under sub heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entries in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entries in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty as a percentage of the CIF value of the subject goods as specified in the corresponding entries in column (7), of the said Table, namely:-

Sl. No.	Sub Heading or	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty as % of
(1)	Tariff Item	(2)		(5)		CIF
(1)	(2) 85340000	(3) Printed Circuit Boards (PCBs)*	(4) China PR	(5) Any country including China PR	(6) Ji'an Shengyi Electronics Co., Ltd. Shengyi Electronics Co., Ltd.	(7) Nil
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	WUS Printed Circuit KEPZ (Kunshan) Co., Ltd. WUS Printed Circuit (Kunshan) Co. Ltd. WUS Printed Circuit (Huangshi) Co., Ltd	Nil
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Jiangxi Xusheng Electronics Co., Ltd	Nil
4	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Jiangmen Suntak Circuit Technology Co., Ltd. Shenzhen Suntak Multilayer PCB Co., Ltd. Dalian Suntak Electronics Co., Ltd. Dalian Suntak Circuit Co., Ltd. Zhuhai Suntak Circuit Technology Co., Ltd.	Nil
5	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Shenzhen Kinwong Electronic Co., Ltd. Jiangxi Kinwong Precision Circuit Co., Ltd. Kinwong Electronic Technology (Longchuan) Co., Ltd. Kinwong Electronic Technology (Zhuhai) Co., Ltd.	14.78%

TABLE

6	-do-	-do-	China PR	Any	Kin Yip Technology	75.72%
0	-40-	-00-	Ciiiia FK	Any country	Electronics (Huizhou)	13.12%
				including	Co., Ltd.	
				China PR	000,200	
7	-do-	-do-	China PR	Any	Shennan Circuits Co.,	Nil
				country	Ltd.	
				including	Nantong Shennan	
				China PR	Circuits Co., Ltd.	
					WuXi Shennan Circuits Co, Ltd.	
8	-do-	-do-	China PR	Any	Kalex Multi-Layer	Nil
0	uo	uo	Cinnu i K	country	Circuit Board	1,11
				including	(Zhongshan) Ltd.	
				China PR	Merix Printed Circuits	
					Technology Limited	
					Guangzhou Termbray	
					Electronics Technology	
					Co., Ltd.	
					Dongguan Meadville	
0					Circuits Co., Ltd.	0.000/
9	-do-	-do-	China PR	Any	Jiangxi Longhai Circuit	8.23%
				country including	Technology Co., Ltd.	
				China PR		
10	-do-	-do-	China PR	Any	Shenzhen Xinweisai	14.06%
				country	Electronics Co., Ltd.	
				including		
				China PR		
11	-do-	-do-	China PR	Any	Kai Ping Elec & Eltek	Nil
				country	Company Limited	
				including China PR	Kai Ping Elec & Eltek No.3 Company Limited	
12	-do-	-do-	China PR	Any	Sunshine Global Circuits	Nil
12	uo	uo	Cinna i K	country	Co., Ltd.	1411
				including	Jiu Jiang Sunshine	
				China PR	Circuits Technology Co.,	
					Ltd.	
13	-do-	-do-	China PR	Any	Inno Circuits Limited	10.14%
				country		
				including		
14	-do-	-do-	China PR	China PR Any	Any, Other than S. No. 1	30%
17	-40-	-40-	Cinita i K	country	to 13	5070
				including		
				China PR		
15	-do-	-do-	Any country	China PR	Any	30%
			other than			
			China PR and			
16	1	1.	Hong Kong			200/
16	-do-	-do-	Hong Kong	Any	Any	30%
				country including		
				Hong		
				Kong		
17	-do-	-do-	Any country	Hong	Any	30%
			other than	Kong		
			China PR and			
			Hong Kong			

 \ast The following PCBs are excluded from the scope of the product under consideration: -

i. PCBs with more than 6 layers

- *ii.* PCBs for use in mobile phone applications
- iii. Populated printed circuit boards of all sizes
- iv. PCBs with embedded copper coin

PCBs with embedded copper coin are those PCBs where a metal block is embedded in the middle of the boards. PCBs with embedded copper coin are mainly used for high powered devices requiring high heat dissipation such as base station amplifier products.

v. Inlay PCB

Inlay PCBs are those where copper, aluminium or other material is inlaid or pressed into the printed circuit board and serves to dissipate the heat of an electronic component through the printed circuit board to a bottom side heat sink. The heat-emitting component (heat source) can be connected directly to the metal inlay. Inlay PCBs are mainly used for high-frequency and high-speed products.

vi. Plated Over Filled Via (POFV) PCB or Via-in-Pad PCB

POFV products are designed to save space by putting the conductive holes into the SMD (Surface Mounted Components) pads to be soldered. In order to avoid subsequent soldering paste flowing into the holes and causing false soldering, the holes need to be filled with resin in advance. Afterwards, the surface is plated flat so that the surface of the pads with holes is smooth and does not affect the soldering. In POFV PCBs, the surface is plated with copper. POFV PCBs are mainly used in products with high reliability requirements like wireless base station products, switches, and routers.

vii. High Density Interconnect (HDI) PCB

HDI PCB are those wherein holes are drilled through laser technology with holes size of ≤ 0.1 mm. Drilling such small holes needs laser drilling. This is a technology with high processing severity. HDI PCBs are mainly used for high-density products like mobile phones, switches, and servers.

viii. Rigid-flex PCBs

Rigid-flex PCBs are the combination of flexible circuit boards and rigid circuit boards. Rigid-flex PCBs accommodate the good properties of both flexible boards and rigid boards. Rigid-flex products are mainly used in mobile phones, automobiles, industrial control and other applications where there is limited space for electronic parts installation.

ix. Packaging substrates / IC packaging

Packaging substrates or Integrated circuit (IC) substrate is a baseboard used for packaging of bare integrated circuit (semi-conductor) chips. They play a crucial role in connecting the PCB to the semiconductor chip. IC Substrate serves to capture the semiconductor chip, routing to link the chip with the PCB, and safeguard, support, and reinforce the IC chip, thereby giving it a thermal dissipation tunnel.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette, and shall be payable in Indian currency.

Explanation. - For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. CBIC-190354/29/2024-TRU Section-CBEC] VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.